

# AP12275\_M2

## Dual Band Wi-Fi® 11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO Bluetooth 5.3® 通信モジュール

AMPAK Technology® AP12275\_M2 は、Wi-FiおよびBluetooth機能を搭載した2230サイズ M.2 (Key E) 規格準拠の無線LANモジュールです。

MIMO方式に対応した802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2) アクセスポイントと接続可能です。802.11ax (デュアルストリーム) 動作時には、最大1,200Mbps の通信速度を実現します。Wi-Fiインターフェースとして SDIO、BluetoothインターフェースとしてUART/PCM を備えています。

本製品は、Wi-FiおよびBluetoothを1モジュールに集約したコンパクトなソリューションとして、タブレット端末、OTTボックス、携帯型機器 などの用途に適しています。



### ●仕様

フォームファクター	M.2 2230 Key E
IC	Synaptics SYN43752
サイズ	22 x 30 x 2.2 mm
Band	2.4GHz / 5GHz
認証	FCC, IC, CE, 技術基準適合証明
Wi-Fi Spec	Wi-Fi®6
Wi-Fi Interface	SDIO
Bluetooth Spec	Bluetooth®5.3
Bluetooth Interface	UART/PCM
動作温度範囲	-30°C ~ 85°C
対応OS	Linux, Android NVIDIA Linux for Tegra対応



AMPAK Technology Inc.は2000年12月に台湾で設立されたIoT向け無線モジュールの製造メーカーです。産業機器やスマートホームデバイス、車載システムなどに、最新規格と高度なセキュリティに対応したワイヤレス無線モジュールを提供しています。

AMPAK TechnologyはGemtek Technology のグループ企業です。

注意：記載された製品仕様及び外観は、改善のため予告なく変更となる場合がございます。最新の仕様は弊社Webをご確認ください。

### 輸入・販売元

東京都千代田区神田佐久間町4-16 PAL K2ビル 5階  
Genix Japan株式会社

### 問い合わせ先

sales@genix-jp.com

